

## **Modulares smartes Produktionssystem für Industrie 4.0**

### **Datenbank**

TEMA, Copyright WTI-Frankfurt eG

### **Deskriptoren**

Elektronikindustrie; intelligentes Fertigungssystem; Industrie 4.0; EU-Förderung; Digitalisierung; Elektronik; Montage; intelligente Fabrik; Modulbauweise

### **Abstract**

Vorgestellt wird das von November 2015 bis Oktober 2018 laufende Förderprojekt ReCaM (Rapid Reconfiguration of Flexible Production Systems through Capability-based Adaption, Auto-configuration and Integrated Tools for Production Planning). Neun unterschiedliche Unternehmen arbeiten an dem Projekt. Ziel ist es, ein neuartiges industrielles Fertigungskonzept zu entwickeln, das die Grundlage für ein smartes modulares Produktionssystem sein wird, das den Anforderungen von Industrie 4.0 gerecht wird und vielfältig einsetzbar ist. Zum Projektende 2018 sollen Grundsatzlösungen bereitstehen, die für den Einsatz in der Elektronikindustrie modifiziert und angepasst werden müssen.

### **Autor**

Poschmann, Hartmut

### **Institution**

Siemens, Berlin, DE; Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) Oberpfaffenhofen, Wessling, DE; Finke Elektronik, Waldkirch, DE; Weidmüller Interface, Detmold, DE; ERNI Production, Adelberg, DE

### **Konferenzangaben**

EBL, 2016, DVS/GMM-Tagung Elektronische Baugruppen und Leiterplatten, 8., Fellbach bei Stuttgart, DE, 2016-02-16 - 2016-02-17  
publiziert als: EBL 2016, 8. DVS/GMM-Tagung Elektronische Baugruppen und Leiterplatten, Multifunktionale Baugruppen - Leistungsdichte am Limit?, Fellbach bei Stuttgart, DE, 16.-17. Feb, 2016

### **Quelle**

PLUS. Produktion von Leiterplatten und Systemen \* Band 19 (2017) Heft 1, Seite 105-109 (5 Seiten, Bilder, Tabellen, 6 Quellen)

### **Publikationscodes**

ISSN: 1436-7505

Zeitschriftencode: 8112 = PLUS. Produktion von Leiterplatten und Systemen